

§1 重要提示
 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网；www.cninfo.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
 1.2 公司年度财务报告已经瑞华会计师事务所 特殊普通合伙 审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
 1.3 公司负责人肖胜群、主管会计工作负责人宋勇及会计机构负责人 会计主管人员 吴树涛声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	华天科技
股票代码	002185
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

董 事 会 秘 书		证 券 事 务 代 表
姓名	常文斌	王亚斌
联系地址	甘肃省天水市秦州区双桥路 14 号	甘肃省天水市秦州区双桥路 14 号
电话	0938-8631816	0938-8631990
传真	0938-8630216	0938-8632260
电子信箱	hcty@20000163.com	wy@hstl.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业收入(元)	4,306,020,880.27	1,161,237,632.02	12.72%	777,436,881.45
营业利润(元)	97,373,005.37	122,696,013.75	-59.76%	85,415,000.65
利润总额(元)	86,613,334.38	130,945,189.94	-33.86%	89,571,065.64
归属于上市公司股东的净利润(元)	78,956,688.94	111,871,226.26	-29.42%	77,199,428.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	47,742,280.40	104,922,334.69	-54.50%	73,164,078.92
经营活动产生的现金流量净额(元)	218,474,741.88	292,492,802.70	-25.31%	232,522,604.07
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	2,207,800,104.16	1,741,504,924.80	32.47%	1,311,514,713.58
负债总额(元)	858,523,092.30	723,294,081.81	18.70%	392,018,025.33
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,443,210,674.32	1,018,736,585.38	42.37%	915,848,024.87
总股本(股)	406,130,000.00	373,230,000.00	8.81%	287,100,000.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.2085	0.2997	-30.43%	0.2067
稀释每股收益(元/股)	0.2085	0.2997	-30.43%	0.2067
归属于上市公司股东的净资产收益率(加权)(%)	1.2681	0.2811	-55.14%	0.1973
加权平均净资产收益率(加权)(%)	7.10%	11.61%	-4.51%	8.79%
扣除非经常性损益后的加权净资产收益率(加权)(%)	4.29%	10.89%	-6.60%	8.39%
经营活动产生的现金流量净额/净利润(%)	0.5379	0.7837	-31.36%	0.8099
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.5536	2.7161	30.83%	3.1900
资产负债率(%)	37.21%	41.53%	-4.32%	29.89%

3.3 非经常性损益项目

适用 不适用

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	69,486.41		-247,100.91	-27,548.03
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、且能够按照名义金额计量的政府补助	36,922,942.64		9,542,643.75	4,249,125.03
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	248,430.86		-1,046,406.65	-65,512.01
所得税影响额	-9,974,411.78		-1,309,043.33	-623,469.75
少数股东权益影响额	-53,086.69		8,796.61	-26,305.97
合计	31,213,808.54		6,948,891.57	3,505,849.27

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

股东名称	持股数量	持股比例(%)	限售股数量	质押或冻结数量
天水华天微电子股份有限公司	10,493,425.00	34.33%	19,425,000.00	0.00
杭州友旺电子有限公司	2,118,400.00	5.45%	3,000,000.00	0.00
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金	1,800,893.00	4.38%	17,800,893.00	0.00
上海浦东发展银行股份有限公司	1,700,000.00	2.07%	8,400,000.00	0.00
宁波富邦源利投资有限公司	1,700,000.00	1.77%	7,200,000.00	0.00
上海浦东发展银行股份有限公司	1,676,000.00	1.67%	6,800,000.00	0.00
中国工商银行股份有限公司	1,400,000.00	1.11%	4,500,000.00	0.00
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金	1,366,613.00	0.89%	3,466,315.00	0.00
中国工商银行股份有限公司-融新 278 号	1,357,454.00	0.85%	457,454.00	0.00
陈国忠	1,074.00	0.74%	3,020,063.00	3,000,000.00

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
天水华天微电子股份有限公司	19,425,000	人民币普通股
杭州友旺电子有限公司	19,188,400	人民币普通股
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金	17,800,893	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司	3,666,313	人民币普通股
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金	3,457,454	人民币普通股
上海浦东发展银行股份有限公司-融新 278 号	3,000,000	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-融新 278 号	2,720,179	人民币普通股
华泰证券股份有限公司	2,058,352	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-融新 278 号	1,800,000	人民币普通股
北京天沃中天基金-兴一行动的	1,663,440	人民币普通股

天水华天微电子股份有限公司为公司控股股东,公司未与其他股东之间是否存在关联关系,不存在一致行动人的情形。

证券代码:002185 证券简称:华天科技 公告编号:2012-007
天水华天科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 天水华天科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议通知和议案等材料已于 2012 年 2 月 22 日通过电子邮件和书面方式发送至各位董事,并于 2012 年 3 月 11 日上午在西安凤城国际酒店召开会议。出席本次会议的董事 9 人,实际到会 9 人。公司监事和共 11 人列席了会议。会议由董事长肖胜群主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议:
 一、审议通过了《关于 2011 年度工作报告和 2012 年工作计划》。
 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 二、审议通过了《2011 年度董事会工作报告》。
 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 三、审议通过了《2011 年度股东大会决议》。
 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 四、审议通过了《关于聘任 2011 年度独立董事的议案》。
 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 五、审议通过了《关于聘任 2011 年度审计机构的议案》。
 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 六、审议通过了《关于聘任 2011 年度会计师事务所的议案》。
 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 七、审议通过了《关于聘任 2011 年度会计师事务所的议案》。
 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 八、审议通过了《关于聘任 2011 年度会计师事务所的议案》。
 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 九、审议通过了《关于聘任 2011 年度会计师事务所的议案》。
 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 十、审议通过了《关于聘任 2011 年度会计师事务所的议案》。
 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

天水华天科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议通知和议案等材料已于 2012 年 2 月 22 日通过电子邮件和书面方式发送至各位董事,并于 2012 年 3 月 11 日上午在西安凤城国际酒店召开会议。出席本次会议的董事 9 人,实际到会 9 人。公司监事和共 11 人列席了会议。会议由董事长肖胜群主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议:
 一、审议通过了《关于 2011 年度工作报告和 2012 年工作计划》。
 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 二、审议通过了《2011 年度董事会工作报告》。
 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 三、审议通过了《2011 年度股东大会决议》。
 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 四、审议通过了《关于聘任 2011 年度独立董事的议案》。
 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 五、审议通过了《关于聘任 2011 年度审计机构的议案》。
 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 六、审议通过了《关于聘任 2011 年度会计师事务所的议案》。
 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 七、审议通过了《关于聘任 2011 年度会计师事务所的议案》。
 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 八、审议通过了《关于聘任 2011 年度会计师事务所的议案》。
 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 九、审议通过了《关于聘任 2011 年度会计师事务所的议案》。
 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 十、审议通过了《关于聘任 2011 年度会计师事务所的议案》。
 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

天水华天科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议通知和议案等材料已于 2012 年 2 月 22 日通过电子邮件和书面方式发送至各位董事,并于 2012 年 3 月 11 日上午在西安凤城国际酒店召开会议。出席本次会议的董事 9 人,实际到会 9 人。公司监事和共 11 人列席了会议。会议由董事长肖胜群主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议:
 一、审议通过了《关于 2011 年度工作报告和 2012 年工作计划》。
 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 二、审议通过了《2011 年度董事会工作报告》。
 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 三、审议通过了《2011 年度股东大会决议》。
 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 四、审议通过了《关于聘任 2011 年度独立董事的议案》。
 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 五、审议通过了《关于聘任 2011 年度审计机构的议案》。
 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 六、审议通过了《关于聘任 2011 年度会计师事务所的议案》。
 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 七、审议通过了《关于聘任 2011 年度会计师事务所的议案》。
 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 八、审议通过了《关于聘任 2011 年度会计师事务所的议案》。
 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 九、审议通过了《关于聘任 2011 年度会计师事务所的议案》。
 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 十、审议通过了《关于聘任 2011 年度会计师事务所的议案》。
 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

天水华天科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议通知和议案等材料已于 2012 年 2 月 22 日通过电子邮件和书面方式发送至各位董事,并于 2012 年 3 月 11 日上午在西安凤城国际酒店召开会议。出席本次会议的董事 9 人,实际到会 9 人。公司监事和共 11 人列席了会议。会议由董事长肖胜群主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议:
 一、审议通过了《关于 2011 年度工作报告和 2012 年工作计划》。
 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 二、审议通过了《2011 年度董事会工作报告》。
 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 三、审议通过了《2011 年度股东大会决议》。
 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 四、审议通过了《关于聘任 2011 年度独立董事的议案》。
 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 五、审议通过了《关于聘任 2011 年度审计机构的议案》。
 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 六、审议通过了《关于聘任 2011 年度会计师事务所的议案》。
 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 七、审议通过了《关于聘任 2011 年度会计师事务所的议案》。
 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 八、审议通过了《关于聘任 2011 年度会计师事务所的议案》。
 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 九、审议通过了《关于聘任 2011 年度会计师事务所的议案》。
 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 十、审议通过了《关于聘任 2011 年度会计师事务所的议案》。
 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

天水华天科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议通知和议案等材料已于 2012 年 2 月 22 日通过电子邮件和书面方式发送至各位董事,并于 2012 年 3 月 11 日上午在西安凤城国际酒店召开会议。出席本次会议的董事 9 人,实际到会 9 人。公司监事和共 11 人列席了会议。会议由董事长肖胜群主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议:
 一、审议通过了《关于 2011 年度工作报告和 2012 年工作计划》。
 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 二、审议通过了《2011 年度董事会工作报告》。
 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 三、审议通过了《2011 年度股东大会决议》。
 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 四、审议通过了《关于聘任 2011 年度独立董事的议案》。
 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 五、审议通过了《关于聘任 2011 年度审计机构的议案》。
 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 六、审议通过了《关于聘任 2011 年度会计师事务所的议案》。
 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 七、审议通过了《关于聘任 2011 年度会计师事务所的议案》。
 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 八、审议通过了《关于聘任 2011 年度会计师事务所的议案》。
 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 九、审议通过了《关于聘任 2011 年度会计师事务所的议案》。
 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 十、审议通过了《关于聘任 2011 年度会计师事务所的议案》。
 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

天水华天科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议通知和议案等材料已于 2012 年 2 月 22 日通过电子邮件和书面方式发送至各位董事,并于 2012 年 3 月 11 日上午在西安凤城国际酒店召开会议。出席本次会议的董事 9 人,实际到会 9 人。公司监事和共 11 人列席了会议。会议由董事长肖胜群主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议:
 一、审议通过了《关于 2011 年度工作报告和 2012 年工作计划》。
 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 二、审议通过了《2011 年度董事会工作报告》。
 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 三、审议通过了《2011 年度股东大会决议》。
 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 四、审议通过了《关于聘任 2011 年度独立董事的议案》。
 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 五、审议通过了《关于聘任 2011 年度审计机构的议案》。
 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 六、审议通过了《关于聘任 2011 年度会计师事务所的议案》。
 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 七、审议通过了《关于聘任 2011 年度会计师事务所的议案》。
 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 八、审议通过了《关于聘任 2011 年度会计师事务所的议案》。
 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 九、审议通过了《关于聘任 2011 年度会计师事务所的议案》。
 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 十、审议通过了《关于聘任 2011 年度会计师事务所的议案》。
 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

天水华天科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议通知和议案等材料已于 2012 年 2 月 22 日通过电子邮件和书面方式发送至各位董事,并于 2012 年 3 月 11 日上午在西安凤城国际酒店召开会议。出席本次会议的董事 9 人,实际到会 9 人。公司监事和共 11 人列席了会议。会议由董事长肖胜群主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议:
 一、审议通过了《关于 2011 年度工作报告和 2012 年工作计划》。
 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 二、审议通过了《2011 年度董事会工作报告》。
 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 三、审议通过了《2011 年度股东大会决议》。
 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 四、审议通过了《关于聘任 2011 年度独立董事的议案》。
 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 五、审议通过了《关于聘任 2011 年度审计机构的议案》。
 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 六、审议通过了《关于聘任 2011 年度会计师事务所的议案》。
 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 七、审议通过了《关于聘任 2011 年度会计师事务所的议案》。
 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 八、审议通过了《关于聘任 2011 年度会计师事务所的议案》。
 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 九、审议通过了《关于聘任 2011 年度会计师事务所的议案》。
 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 十、审议通过了《关于聘任 2011 年度会计师事务所的议案》。
 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

天水华天科技股份有限公司
2011 年度 报告摘要

证券代码:002185 证券简称:华天科技 公告编号:2012-006



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、报告期内经营情况回顾
 2011 年公司加快实施了产业发展调整布局、工艺升级改造以及铜线制程扩产和材料优化升级工作:一是公司投资山西微敏电子科技有限公司 55%的股权,并参与该公司的生产管理,初期从事 TVS 封装技术领域;二是华天科技(西安)微电子股份有限公司工艺升级改造及材料优化升级工作,三是华天科技(西安)微电子股份有限公司工艺升级改造及材料优化升级工作。
 2011 年,公司营业收入和净利润分别较 2010 年分别增长 19.27%和 12.72%,由于原材料人工成本、固定资产折旧费用增加以及铜线制程扩产,使公司的营业利润和归属于母公司所有者的净利润较 2010 年分别下降了 59.76%和 20.42%。
 1.集成电路产业的发展趋势
 (1)集成电路产业的发展趋势
 根据《中国半导体集成电路封装市场统计数据和公司历年收入情况报告》,公司在 2008-2010 年的市场占有率从 1.20%逐步提升至 1.85%,除国内集成电路封装产业 2011 年的市场规模和公司 2011 年销售总额外,公司市场占有率进一步提升。来自国内国际半导体 IDM 公司在华设立的研发制造厂不断增加,但面临着订单和产能的国内地转移,公司作为国内专业代工厂,将长期保持高景气度,在封装、封装材料、封装设备、封装工艺、封装技术等方面展开合作。
 (2)未来公司发展的机遇和挑战
 1. 封装工艺的快速发展
 ① 封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺发展迅速,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接。
 ② 封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接。
 ③ 封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接。
 ④ 封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接。
 ⑤ 封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接。
 ⑥ 封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接。
 ⑦ 封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接。
 ⑧ 封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接。
 ⑨ 封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接。
 ⑩ 封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接。
 ⑪ 封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接。
 ⑫ 封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接。
 ⑬ 封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接。
 ⑭ 封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接。
 ⑮ 封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接。
 ⑯ 封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接。
 ⑰ 封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接。
 ⑱ 封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接。
 ⑲ 封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接。
 ⑳ 封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接。
 ㉑ 封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接。
 ㉒ 封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接。
 ㉓ 封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接。
 ㉔ 封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接。
 ㉕ 封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接。
 ㉖ 封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接。
 ㉗ 封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接。
 ㉘ 封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接。
 ㉙ 封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接。
 ㉚ 封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接。
 ㉛ 封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接。
 ㉜ 封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接。
 ㉝ 封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接。
 ㉞ 封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接。
 ㉟ 封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接。
 ㊱ 封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接。
 ㊲ 封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接。
 ㊳ 封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接。
 ㊴ 封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接。
 ㊵ 封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接。
 ㊶ 封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接。
 ㊷ 封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接。
 ㊸ 封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接。
 ㊹ 封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接。
 ㊺ 封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接。
 ㊻ 封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接。
 ㊼ 封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接,封装工艺和集成电路产业“十二五”发展规划相衔接。
 ㊽ 封装